

プリント基板 部品実装サービス仕様書

運営：マツイ電子株式会社

※記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

目次

- 1.適用範囲
- 2.実装仕様
- 3.実装必要情報
 - 3.1 実装での必要データ
 - 3.2 実装必要資料詳細
- 4.メタルマスク
- 5.実装注文における注意について
- 6.支給部品について

1. 適用範囲

本仕様書は、マツイ電子株式会社が運営する「試作基板.com」にて販売されるプリント基板の部品実装サービスに適用される。

2. 実装仕様

実装方法	実装条件	基板外形	メタルマスク
手半田	<ul style="list-style-type: none"> ・最小チップサイズ：1005サイズ ・QFP最小ピッチ：0.4mm ・BGA.CSP.LGA.QFF 手半田不可 	10×10mm以上	不要
手載せ	<ul style="list-style-type: none"> ・1台あたりの部品点数：400点まで ・BGA ボールサイズ0.3mm・ピッチ0.5mm以上 ・基板内に認識マークがあると尚可 	10×10mm以上	必要
マウンタ	<ul style="list-style-type: none"> ・基板もしくは捨て基板に認識マーク必須 ・捨て基板の設置を推奨とする (捨て基板サイズ：10～20mm幅) 	50×50mm以上	必要

[各部品の対応範囲]

- ・ DIP(挿入部品)
 - アキシャル・ラジアル・異型部品
- ・ SMD(面実装部品)
 - 搭載最小チップ 0603サイズ以上
 - QFP ピッチ：0.4mm以上
 - BGA/LGA ピッチ：0.4mm以上・寸法：5～45mm
 - コネクタ 0.4mm以上
 - トランジスタ・CSP・SOP ピッチ：0.4mm以上・寸法：5～45mm
 - 特殊形状など 別途ご相談

[注意が必要なケース]

- ・ コネクタやICが多い、部品点数・枚数が多いケースは、部材確認後に実装方法の変更を要請する場合がある。
- ・ 0402サイズのチップは、内容を確認の上、個別見積とする。
- ・ 0603サイズのチップは、マウンタ対応での実装とする。

3. 実装必要情報

3.1 実装での必要データ

実装方法	実装図	部品一覧表	部品座標データ	メタルマスク ガーバーデータ
手半田	◎	◎	任意	×
手載せ	◎	◎	任意	◎
マウンタ	◎	◎	◎	◎

3.2 実装必要資料詳細

・実装図

- 1.部品位置
- 2.部品向き
- 3.特殊部品の実装方法の指示
- 4.極性部品(IC・LEDなど)はピンマーク表記必須
 ※基板のシルク図だけでは情報不足になる場合があるため、
 極性部品や特殊部品は、別途、実装指示書の作成する方が良い。

・部品一覧表

- 1.部品メーカー・部品メーカー型番
- 2.部品リファレンス番号
- 3.実装部品形状 DIP or SMD
- 4.実装有無表記 実装 or 未実装

4.メタルマスク

- ・材質 ステンレスSUS
- ・サイズ 650×550mm
- ・板厚 標準：0.12mm ※内容に応じて、0.1/0.11/0.15mmを使用する場合あり
- ・保管 当社で製作したメタルマスクは、当社で保管とする。
 お客様支給の場合は、実装完了後、製品・残部品と共に返却とする。

5.実装注文における注意について

- ・実装進行途中で部品不足による未実装がある場合、当初のご注文金額のまま請求とする。
- ・同じ基板で異なる部品を実装する場合、部品一覧表は個別に用意すること。
- ・同種の面付は、一案件で対応可能。
- ・異種面付の場合は、部品リファレンス番号が重複しなければ、一案件で対応可能。
 重複する場合は、別案件として、各資料の準備が必要とする。

6.支給部品について

- ・表面実装部品
 基本は、リールもしくはカットリールで提供のこと。
 余った部品は、実装した基板と共に、返却する。
- ・挿入部品
 バラ支給可。但し、足が曲がってしまう可能性があるため、リールカットもしくは
 トレイに乗った状態で支給のこと。

※部品は、各部品ごとに袋に入れ、その袋に部品リファレンスと個数の記載をすること。
 また、部品一覧表と実装図を同梱で送付頂くと尚可。

